

## 연수 제안서

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 연구 분야  | 압전 소재 및 소자 개발                   |
| 연구 과제명   | TGG 기반 Hard 압전 재료 및 초음파트랜스듀서 개발 |
| 연수 제안 업무   | 소재, 공정, 소자 개발                   |
| <p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2021.01.01. ~2022. 12. 31</p> <p>- 연수 내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 압전 hard 소재 개발</li><li>- 결정립 배향용 시드 개발</li><li>- 결정립 압전 hard 소재 개발</li><li>- 압전 트랜스듀서 설계 및 개발</li><li>- 하이브리드 압전 에너지 하베스팅 기술 개발</li><li>- 광대역 압전 에너지 하베스팅 기술 개발</li></ul> |                                 |
| 소속 부서 : 전자재료연구센터   |                                 |
| 연수 책임자 : 강종윤   |                                 |